
柔性无机电子转印技术

作者：writer 来源：科学网

本文原地址：<https://www.iikx.com/news/progress/3725.html>

本文仅供学习交流之用，版权归原作者所有，请勿用于商业用途！



TRANSFER PRINTING TECHNIQUES



柔性无机电子转印技术。近十年，柔性无机电子飞速发展，并取得了巨大的成就。通过将硬质无机半导体材料整合至具有柔性衬底的精密结构布局中，可消除传统电子相关的二维刚性易碎的设计束缚，产生多种新型应用：如曲线电子、复合生物电子、表皮电子、瞬态电子以及可变形光电子等。

转印技术是一项可用于微加工及纳米制造的新兴装配技术，可将不同类别的材料异构合成至所需的功能布局中。它为柔性无机电子提供了工程领域机会，可使其在传统晶片型设备的基础上像橡胶一样变形，将预制无机半导体材料及设备转印至非传统的柔性衬底上。

Jizhou Song 教授和合作者们在 npj Flexible Electronics 发表了题为 Transfer printing techniques for flexible and stretchable inorganic electronics 的文章，该综述简要回顾了近来柔性无机电子转印技术的发展，对每种转印技术的基本概念进行了回顾、比较和总结(包括表面化学和胶水辅助转印技术、动力控制转印技术、激光驱动非接触式转印技术、壁虎式转印技术、蚜虫启发转印技术)，并对其未来发展、应用及挑战进行了展望。

更多 科学进展 请访问 <https://www.iikx.com/news/progress/>

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，[爱科学iikx.com](https://www.iikx.com)转发